達興材料 (5234 TT)

法 人 說 明 會

2026 年第三季 | 2026.11.16

半導體材料 | 顯示器材料 | 關鍵原材料



A Materials Design House and More

免責聲明

1. 本簡報及同時發佈之相關訊息內含有從公司內部與外部來源所取得之前瞻性資訊。本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展望，可能與這些前瞻性陳述有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險及不確定性。

2. 本簡報中對未來的展望，是基於本公司目前可得資訊對未來事件的期望和預測，未來若有任何變更或調整時，本公司將不承擔隨時提醒或更新之責任。

3. 本簡報財務數字依國際財務報導準則（IFRS）編製，2026 年第三季數字為會計師核閱數。

簡報大綱

01 營運成果

02 成長引擎

03 競爭優勢

04 長期展望

深耕材料領域20年，拓展多元產品佈局



創立日期	2006/7 設立
上市日期	2012/7（股票代號 5234）
資本額	新台幣 10.27 億元
員工人數	>450 人，研發人員過半
2025 營收	新台幣 46.30 億元
獲證專利	341 件（累計申請 471 件）

70.9%
3Q26 營收占比

顯示器材料

LCD 材料（CF、Cell、Array）
MicroLED、EPD 材料

27.1%
3Q26 營收占比

半導體材料

晶圓製程材料（先進、成熟製程）
先進封裝材料（2.5D / 3D IC）

2.0%
3Q26 營收占比

關鍵原材料及其他

高機能單體、高純度高分子
（電子材料、半導體、綠能）

01 營運成果

01 營運成果
02 成長引擎
03 競爭優勢
04 長期展望



3Q26 營收創單季新高

單季營運與去年同期比較

營業收入	毛利率	營業利益
13.8 億元	**41.3%**	**2.7 億元**
YoY +16.5% | QoQ +7.8%	YoY +1.6 ppt（3Q25 39.7%）	YoY +31.1%（3Q25 2.1 億元）
稅後淨利	每股盈餘（EPS）	半導體材料營收占比
2.3 億元	**2.29 元**	**27.1%**
YoY +20.0%（3Q25 2.0 億元）	3Q25 1.90 元	3Q25 19.0%

營收創高、半導體材料比重提升，帶動獲利表現優於營收成長

註：YoY = 年增率；QoQ = 季增率

財務績效｜營收與獲利表現

單位：新台幣百萬元；EPS為元

項目	3Q26	2Q26	3Q25	QoQ	YoY	YTD 3Q26	YTD 3Q25	YoY
營業收入	1,381.9	1,281.7	1,186.2	7.8%	16.5%	3,864.9	3,443.4	12.2%
營業毛利	570.1	549.9	470.6	3.7%	21.1%	1,637.8	1,389.9	17.8%
毛利率	41.3%	42.9%	39.7%	-1.6ppts	+1.6ppts	42.4%	40.4%	+2.0ppts
營業利益	**274.5**	**257.5**	**209.4**	**6.6%**	**31.1%**	**773.3**	**636.5**	**21.5%**
營業利益率	19.9%	20.1%	17.6%	-0.2ppts	+2.3ppts	20.0%	18.5%	+1.5ppts
稅後淨利	**234.9**	**228.8**	**195.8**	**2.7%**	**20.0%**	**690.8**	**548.0**	**26.1%**
每股盈餘 EPS	**2.29**	**2.23**	**1.90**	**2.7%**	**20.5%**	**6.73**	**5.33**	**26.3%**

前三季累計營收年增 12.2%，營業利益年增 21.5%，稅後淨利年增 26.1%，獲利成長優於營收成長。

財務結構與營運資金管理

單位：新台幣百萬元

項目	3Q26	2Q26	3Q25
現金及定存	990	1,142	1,380
存貨	495	482	387
不動產、廠房及設備	1,529	1,542	1,449
資產總計	**5,245**	**4,841**	**4,837**
負債總計	1,694	1,526	1,519
權益總計	**3,551**	**3,315**	**3,318**
流動比率	246%	236%	258%

註：現金及定存包含三個月以上定存。

前三季營業現金流

431 百萬元

去年同期 546 百萬元

前三季資本支出

250 百萬元

去年同期 165 百萬元

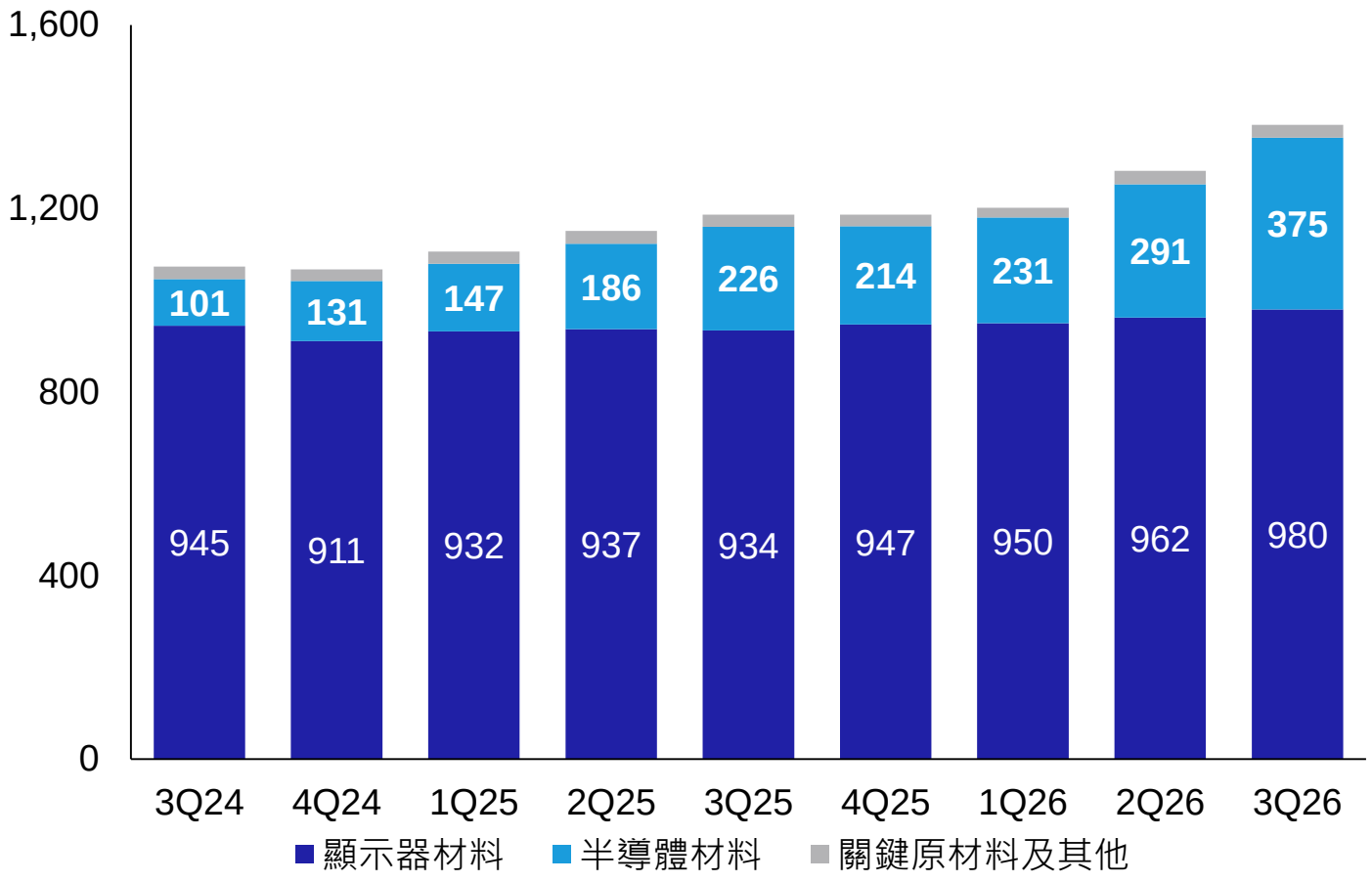
存貨週轉天數

56 天

2Q26：58 天

半導體材料占比提升，為關鍵成長引擎

季度營收（新台幣百萬元，單季）



8.96 億元

前三季26 半導體材料營收（YoY +60.3%）

19.0% → 27.1%

半導體材料營收占比（3Q25 → 3Q26）

約 50：50

先進封裝：先進製程佔半導體材料營收比重

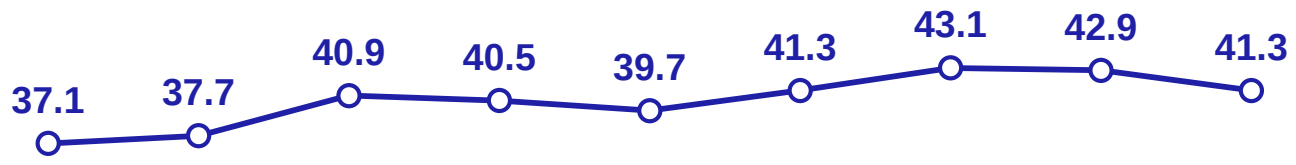
約 30%

4Q26 半導體材料預計營收占比

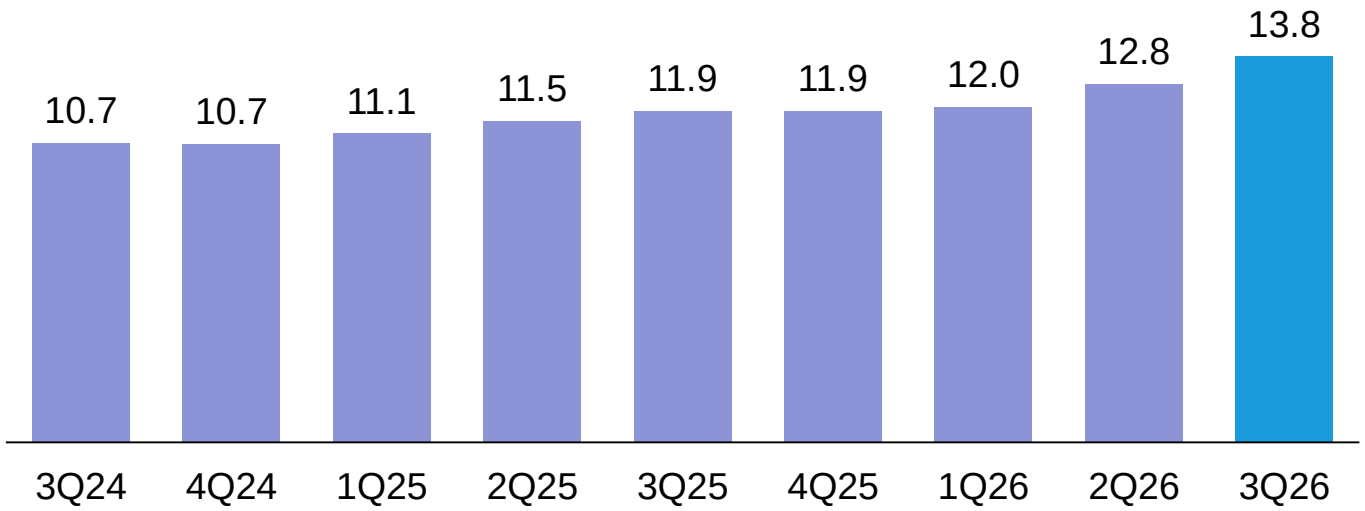
營收穩健成長，毛利率逐步提升

毛利率與營收，單季

毛利率（%）



營收（新台幣億元）



1 **半導體材料占比提升**

3Q25 19.0% → 3Q26 27.1%，產品組合優化帶動毛利提升

2 **持續優化產品及成本結構**

縮減低毛利產品，原料自製，關鍵單體與高分子自行合成

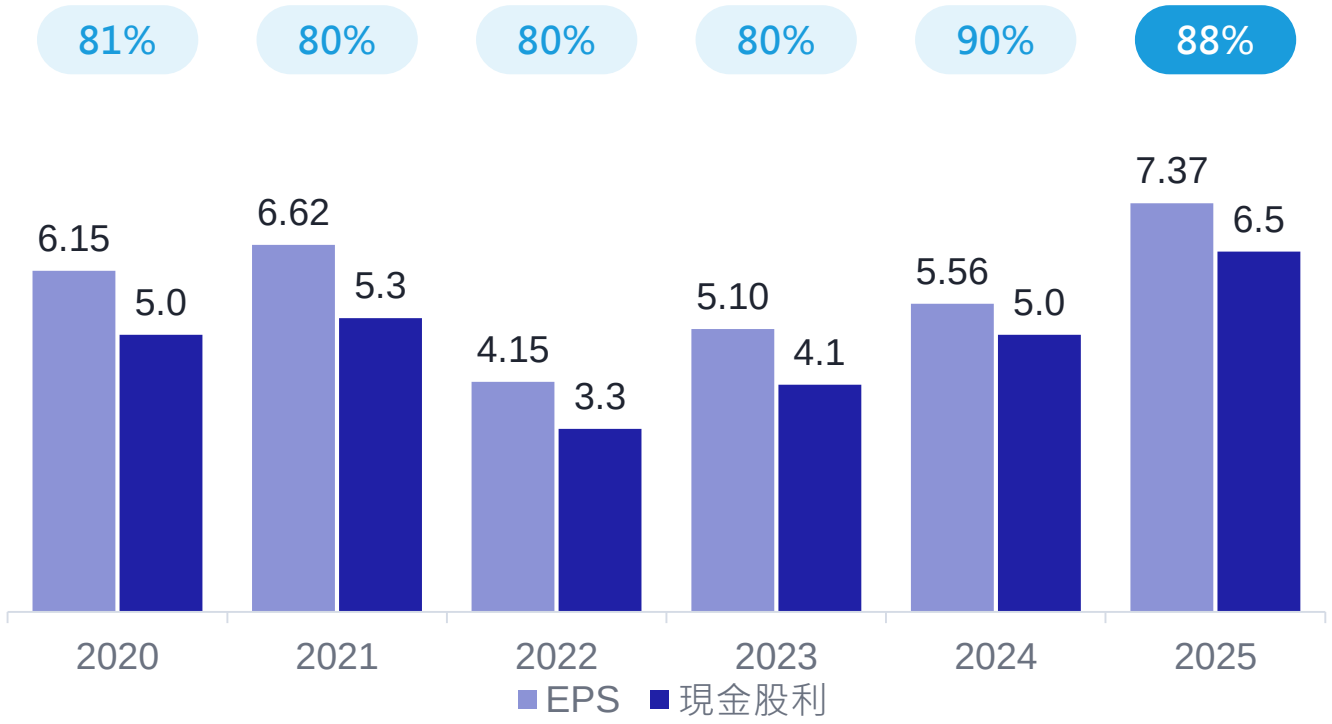
3 **短期變數：原物料與匯率**

毛利率（前三季25 → 前三季26）

40.4% → 42.4%

維持穩定股利政策、兼顧未來資本支出

EPS 與現金股利（元），上排為配發率



半導體材料拉升獲利

占比提升帶動整體獲利

審慎產能投資

依客戶驗證進度規劃產線，折舊攤銷約占營收5%~6%

02 成長引擎



三階段發展策略：從面板到半導體與先進材料平台

從 LCD 材料到半導體先進製程與先進封裝，達興目標打造橫跨材料、製程與設備的整合平台，目標持續提升整體獲利率，創造可持續的長期股權價值成長。

領先全球

感光間隙材 PS 市占

達興1.0 面板材料
2006–2016

LCD 材料開發與量產
PS、PSA PI 全球領先

23.2%

2026年前三季 半導體營收占比
(2025年：16.7%)

達興2.0 半導體材料
2016–2026

先進封裝離型層切入
延伸至晶圓先進製程
2018 年開始出貨

> 50%

2030前 半導體營收占比目標

達興3.0 材料解決方案
2026–

從先進製程延伸至材料、製程、設備與測試，提供材料整體解決方案
策略合作、材料 foundry
與設備商前期合作

半導體材料需求成長，在地化趨勢明確

全球半導體材料

1,424 億美元

2035 年市場規模

2025-35 年 CAGR +5.2%

濕製程化學品

88 億美元

2035 年市場規模

2025-35 年 CAGR +6.8%

先進封裝市場

886 億美元

2035 年市場規模

2025-35 年 CAGR +8.4%

台積電在地採購

68%

2030 年 在地採購目標

先進製程與封裝帶動材料用量，在地化擴大本土材料商導入機會

資料來源：MARKET RESEARCH FUTURE、Precedence RESEARCH、TSMC 2025 Sustainability Report

AI 帶動先進製程與先進封裝產品線並進

先進製程

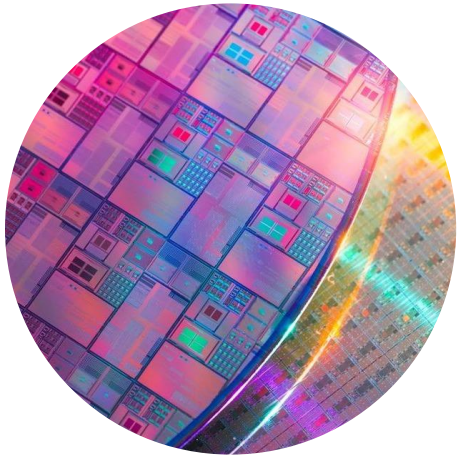
先進節點 / 新世代材料

Wet–Remover A	乾蝕刻後清洗液
Wet–Etchant B	銅蝕刻液
Wet–Stripper B	光阻剝離液

成熟製程

濕製程/微影製程材料在地化

Litho–Polymer A/B/C	光阻用高分子
Litho–Thinner	高純度溶劑
Wet–Stripper	抗反射層剝離液



特化材料
主要產品線

先進封裝

AI 晶片 2.5D / 3D IC 擴產

Specialty–RL	雷射離型層
Wet–Etchant A	銅蝕刻液
Wet–Stripper A	光阻剝離液
PSPI	感光介電絕緣材

顯示器材料

PS、PSA PI 全球領先市佔率

PS	感光間隙材
PSA PI	液晶配向膜
Cu Etchant	銅蝕刻液

顯示器材料業務穩健，半導體材料業務強勁成長

關鍵產品已進入先進封裝與先進製程量產

先進封裝

Specialty–RL

雷射離型層

自主開發 | 量產

「二合一」一層取代兩層製程

先進封裝

Wet–Etchant B

高選擇比銅蝕刻液

自主開發 | 量產

2025 年進入量產

先進製程

Wet–Remover A

乾蝕刻後清洗液

自主開發 | 量產

2025 年進入量產

成熟製程

Litho–Polymer A/B/C

光阻用高純度高分子

策略合作 | 量產

為國際材料大廠合成

先進製程

2 奈米製程材料

2 項產品

自主開發 | 策略合作 | 量產

導入客戶 2 奈米製程

顯示器

PSA PI

液晶配向膜

自主開發 | 量產

1st source 突破日系壟斷

透過多元合作模式，將持續增加新品項

新產品開發 **8 項**

驗證中 **14 項**

2H26 上線驗證 **5 項**

目前量產 **13 項**

註：上線驗證 5 項屬驗證中品項；量產品中自主開發7項與策略合作6項

8 項

新產品 自主開發 | 共同開發

6 家

國際化學大廠策略合作

合作模式

- 雙贏策略: 共同開發及多元合作
- 精密製造: 配方、合成、純化
- 材料 Foundry: 夥伴研發、達興製造

中港廠擴產搭配橋科新廠，充足產能推進半導體業務

台中 **中科廠**

營運總部、研發中心、半導體材料、顯示器材料

台中 **中港 1 廠**

顯示器材料、半導體材料

台中 **中港 2 廠**

半導體：1F 約 10 條線，2F 新線建置中，3–4F 已備妥

高雄 **橋科新廠（規劃中）**

先進半導體 + 關鍵原材料；22 億元，2029 年貢獻

31.4%

海外營收占比（3Q26；2025 年 36.0%）

中國

LCD 材料在地供應

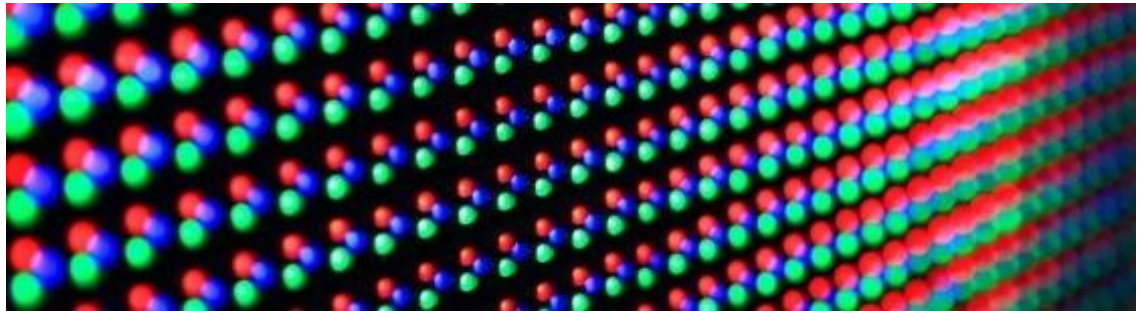
美國客戶據點

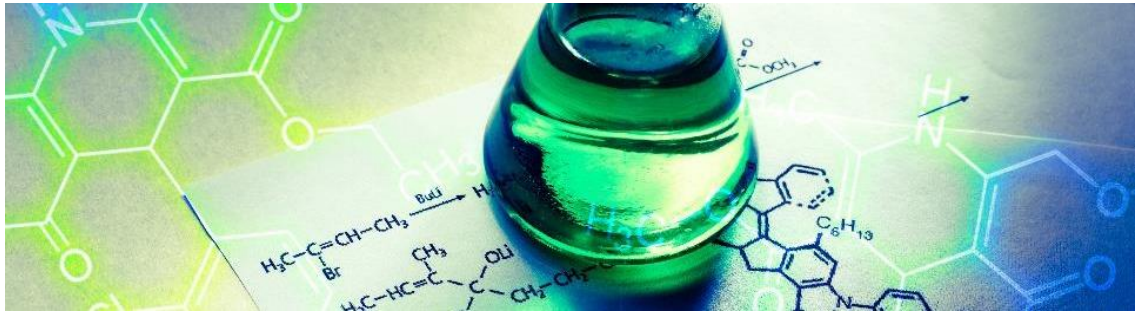
台灣出貨支援，在地生產評估中

產線建置

每條線 4–6 個月，驗證階段即建置

顯示器材料布局高值化新應用





70.9% **顯示器材料：高值化**

3Q26 營收占比

- PS、PSA PI 全球領先市占
- PSA PI 導入新量產廠區；電子紙配向膜放量
- 低溫 ESG 材料、電競與 MicroLED 光通訊材料

2.0% **關鍵原材料及其他：新應用**

3Q26 營收占比

- 高機能單體、高純度高分子、矽負極高分子、矽水膠
- 低介電（Low-Dk / Df）材料推進驗證
- AI 載板、散熱與電動車材料布局中

03 競爭優勢



多重競爭優勢

研發資源

> 50%

研發人員占比

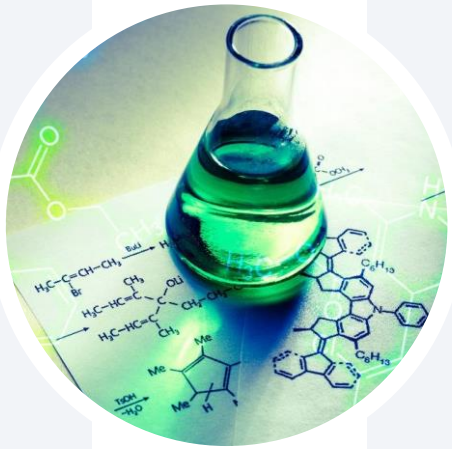
研發費用占營收 10–12%；博士員工占比業界最高

上游合成

341 件

獲證專利

關鍵單體及高分子自行合成，也供應同業



驗證門檻

約 2~3 年

離型層開發到驗證完成

專線專用，驗證導入後與客戶長期合作

經濟規模

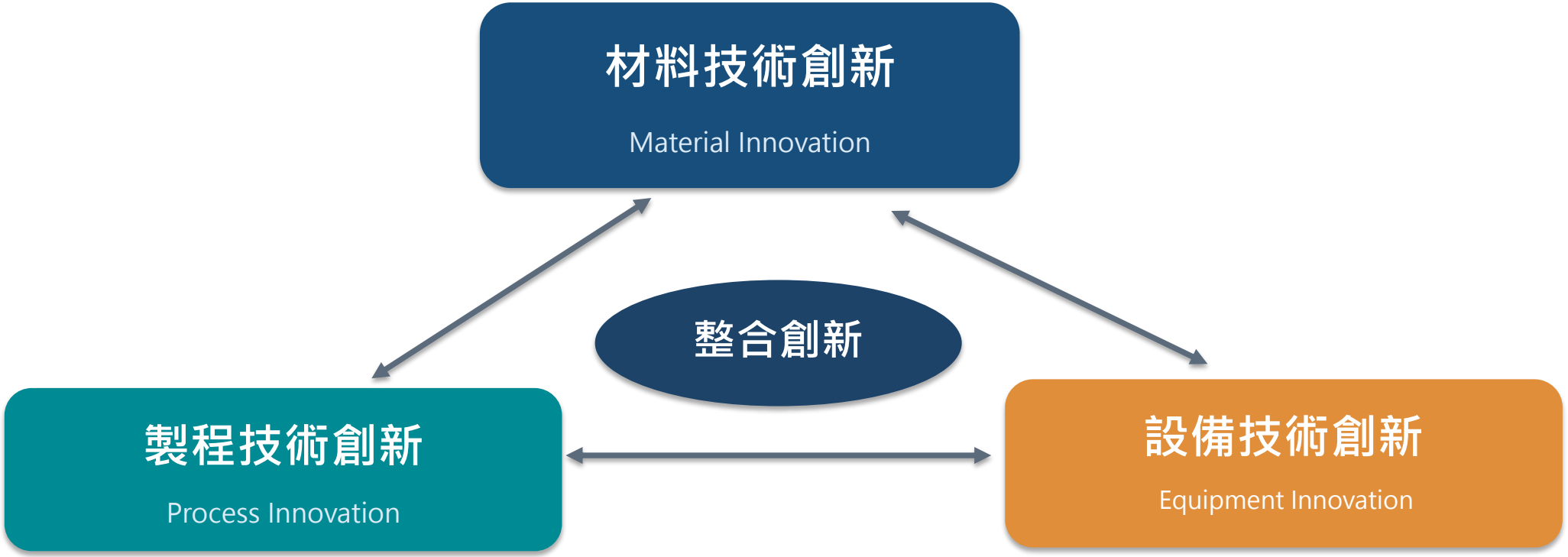
領先市佔

感光間隙材 PS

離型層

三大技術創新，建立核心競爭優勢

三大技術整合創新，持續突破材料與製造的既有限制



創造其他競爭者難以實現的差異化產品

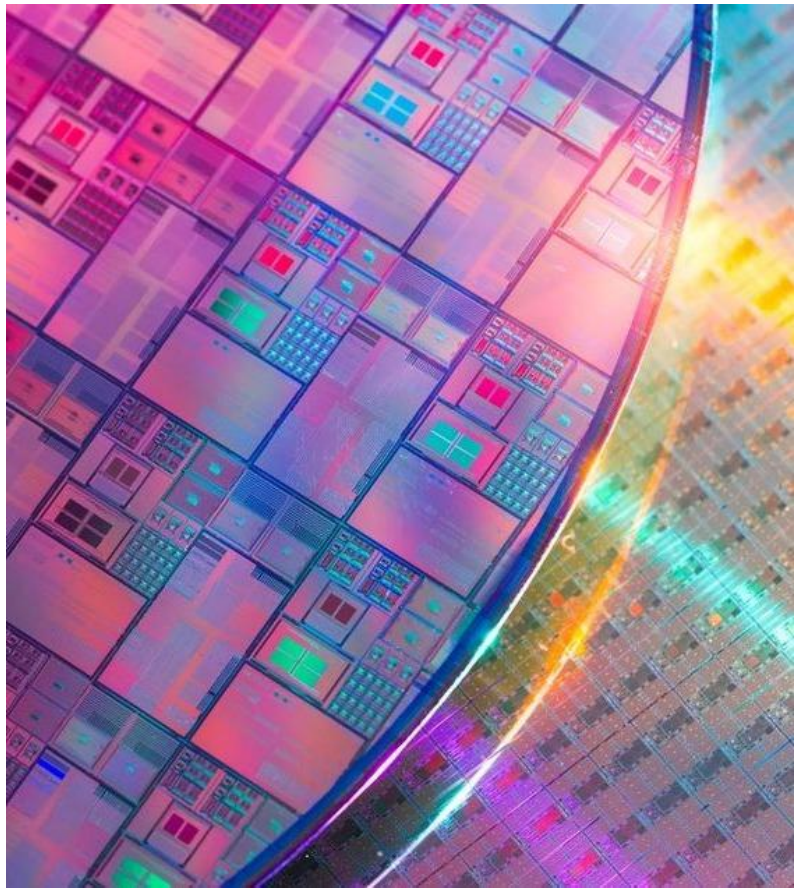
獨特產品價值 × 技術競爭門檻 × 長期競爭優勢

04 長期展望



2027年新品接棒

2027 營運目標　營收維持雙位數年增率 | 獲利率提升



新品量產接棒

多項新品 2027 量產；2027年規劃再建至少 10 條線

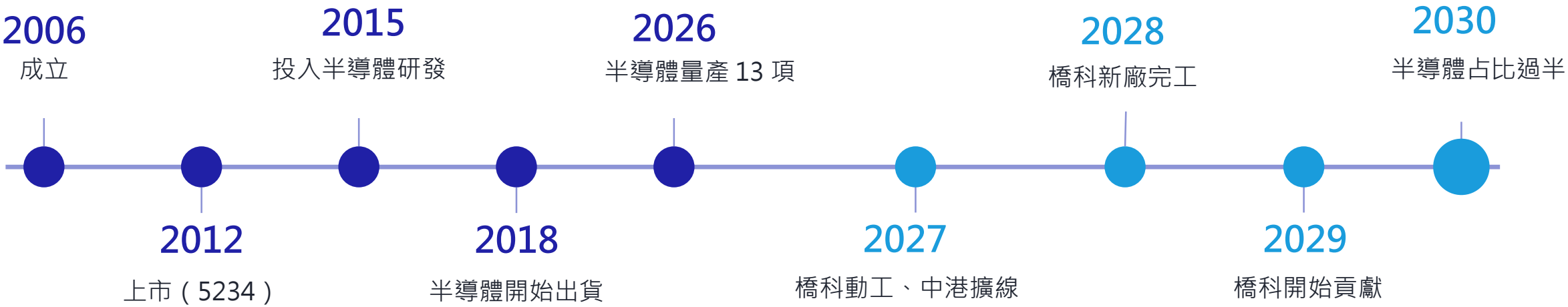
先進節點與封裝擴大導入

隨客戶新世代節點與先進封裝擴大 POR 導入

多元策略合作

與國際化學大廠由單一產品延伸為共同開發

橋科新廠2029年量產



中港擴線

2–4F 空間已備妥；每條線 4–6 個月建置

橋科新廠

22 億元（不含設備）；2027Q1 動工、2029 貢獻

海外支援

台灣出貨支援美國客戶，在地生產評估中

Q & A

謝謝聆聽 | Thank you

www.daxinmat.com

ir@daxinmat.com

半導體材料 | 顯示器材料 | 關鍵原材料 | A Materials Design House and More

